

SHAPING A SUSTAINABLE FUTURE

共塑可持续未来

IPC[®] CEMAC
2025

2025 IPC 电子制造年会

2025 IPC Electronics Manufacturing Annual Conference

活动时间：2025年9月25日-9月26日

活动地点：上海大华锦绣皇冠假日酒店-2楼（上海市浦东新区锦尊路399号）

主办单位：IPC国际电子工业联接协会

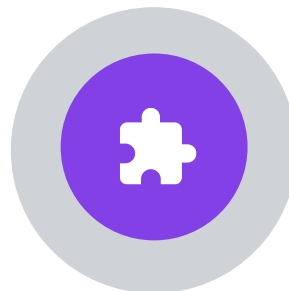
上海市浦东新区质量技术协会

目录



活动信息

- ▶ 关于 CEMAC
- ▶ 内容简介
- ▶ 主题论坛
- ▶ 日程概览



参与方式

- ▶ 赞助方案
- ▶ 选位规则
- ▶ 投稿邀请
- ▶ 报名参会

关于 CEMAC

IPC CEMAC 电子制造年会是会员专属的年度盛会，旨在推动电子产业的技术创新、标准化发展与国际合作。会议通过主题论坛、专业委员会会议、标准开发技术组会议及特别交流活动等丰富形式，为电子制造领域的专家、学者与企业管理者提供一个高效、专业的国际交流平台。

2025年CEMAC年会以“**Shaping a Sustainable Future**（共塑可持续未来）”为主题，聚焦先进封装、新兴产业、PCB/PCBA技术、AI与数字化转型以及ESG可持续发展等热点话题，致力于引领行业迈向更加创新、智能和绿色的未来。



内容简介

项目发布



发布《IPC电子制造业年度发展报告》，发布新标准、新课程、示范项目等，共同见证行业的创新发展。

技术论坛



设立四大主题论坛，聚焦先进封装、新兴产业、PCB/PCBA技术、AI与数字化转型、绿色制造与ESG可持续发展等话题，深入探讨各行业前沿创新技术和趋势，激发参会者的思考和启发，见证行业创新发展与合作。

委员会与标准开发 技术组会议



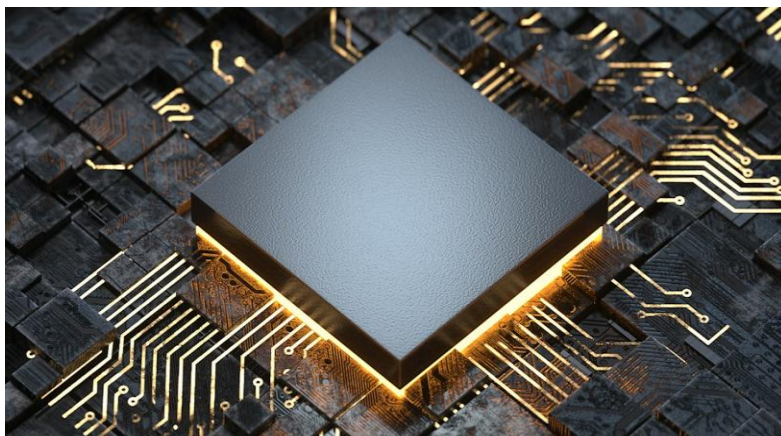
围绕标准发展、人才培养、汽车电子、智能制造等重点方向，紧扣行业趋势与市场需求，通过案例研讨、指导文件制定、项目合作等方式推动可行性解决方案的落地与应用，助力电子制造业加快构建面向未来的新质生产力。

特别活动

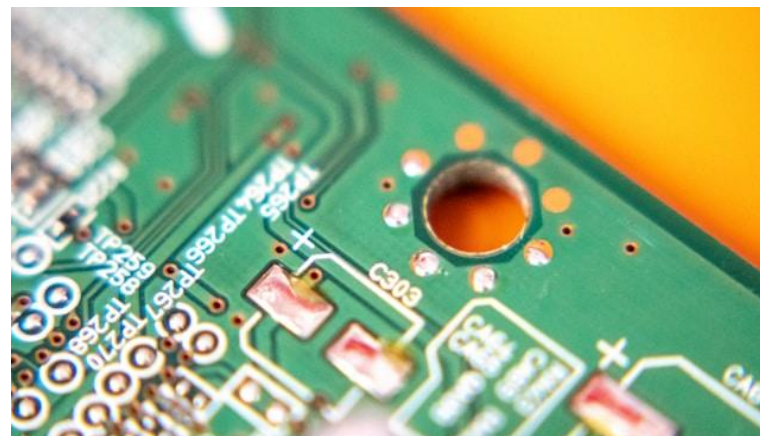


设置专属活动，向合作伙伴、委员会成员，以及在行业发展中作出杰出贡献的企业与个人予以感谢及表彰。

主题论坛



先进封装技术与未来生态构建



新兴产业驱动下PCB&PCBA的机遇和挑战



电子制造ESG可持续发展探索和实践



电子制造的数智化转型升级

日程概览

	主题论坛	专业委员会会议	标准开发技术组会议	特别活动
9/25 上午	开幕式暨主旨演讲 论坛一： 电子制造的数智化转型升级	IPC CAEC 中国汽车电子指导委员会会议	IPC-6931 光模块印制板的要求与验收	合作伙伴午宴
9/25 下午	论坛二： 新兴产业驱动下PCB&PCBA的机遇和挑战	IPC AESC 亚洲教育指导委员会会议	IPC-2553 基于模型的板级有限元分析及可靠性虚拟验证指南	
9/26 上午	论坛三： 先进封装技术与未来生态构建	IPC ASSC 亚洲标准指导委员会会议	IPC-1401B ESG 管理体系标准 IPC-CFX-2591-V2.0 互联工厂数据交换 & IPC-HERMES-9852-V1.6 表面贴装技术组装中机器对机器通信 的全球标准	
9/26 下午	论坛四： 电子制造ESG可持续发展探索和实践	IPC CISM 中国智能制造指导委员会会议	IPC-7077 微电子组装行业引线键合工艺、材料的要求及可接受性	委员会招待会 IPC会员答谢及表彰晚宴

注：上述日程仅供参考，实际以现场为准。



成为赞助商

<https://go.ipc.org.cn//658623/2024-10-18/877jg>

高级赞助商

¥38,000

支持赞助商

¥10,800

IPC 官方及合作伙伴平台宣传推广	✓	✓
现场展示企业 Logo 包括主背景板、会议议程画面	✓	✓
提供企业展示区域 包含宣传背景板及展示桌	✓	✓
与会名录 同意授权的人员信息	✓	✓
宣传资料入袋发放	✓	✓
企业定制专属版海报与邀请函	✓	✓
晚宴现场为企业颁发荣誉证书和鸣谢	✓	✓
享有一场专题演讲时段 30分钟	✓	
论坛主画面显示企业Logo	✓	
优先选择展位位置	✓	
享有免费参加晚宴名额 邀请制	4张	2张
享有免费参加合作伙伴午餐会名额 邀请制	2张	

基于上述赞助，您还可叠加赞助以下项目：

午餐赞助

¥10,000 / 场

午餐餐券和指示牌展示企业名称 Logo

独家
权益

晚宴赞助

¥20,000

晚宴开场前播放企业宣传视频、晚宴餐券和指示牌展示企业Logo、特别鸣谢

晚宴礼品赞助

¥10,000或提供
等价的礼品实物

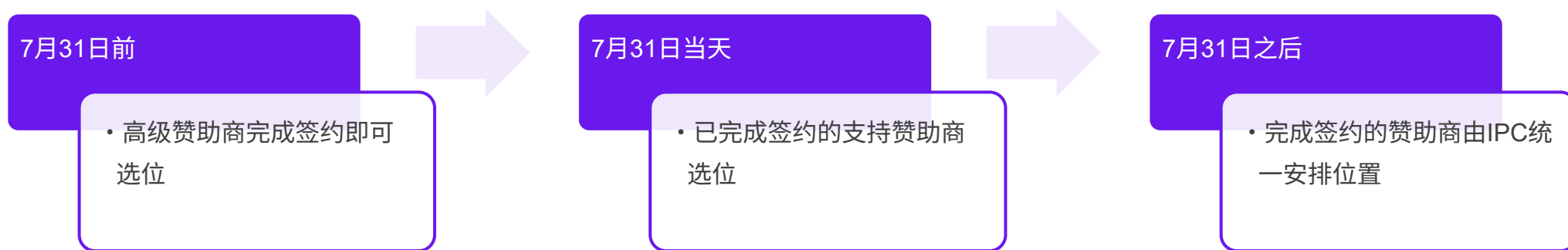
晚宴主画面展示企业Logo、礼品印制企业Logo、特别鸣谢

选位规则

■ 选位优先级：

1. 级别优先：高级赞助商优先于支持赞助商
2. 时间优先：先签约赞助商优先于后签约赞助商

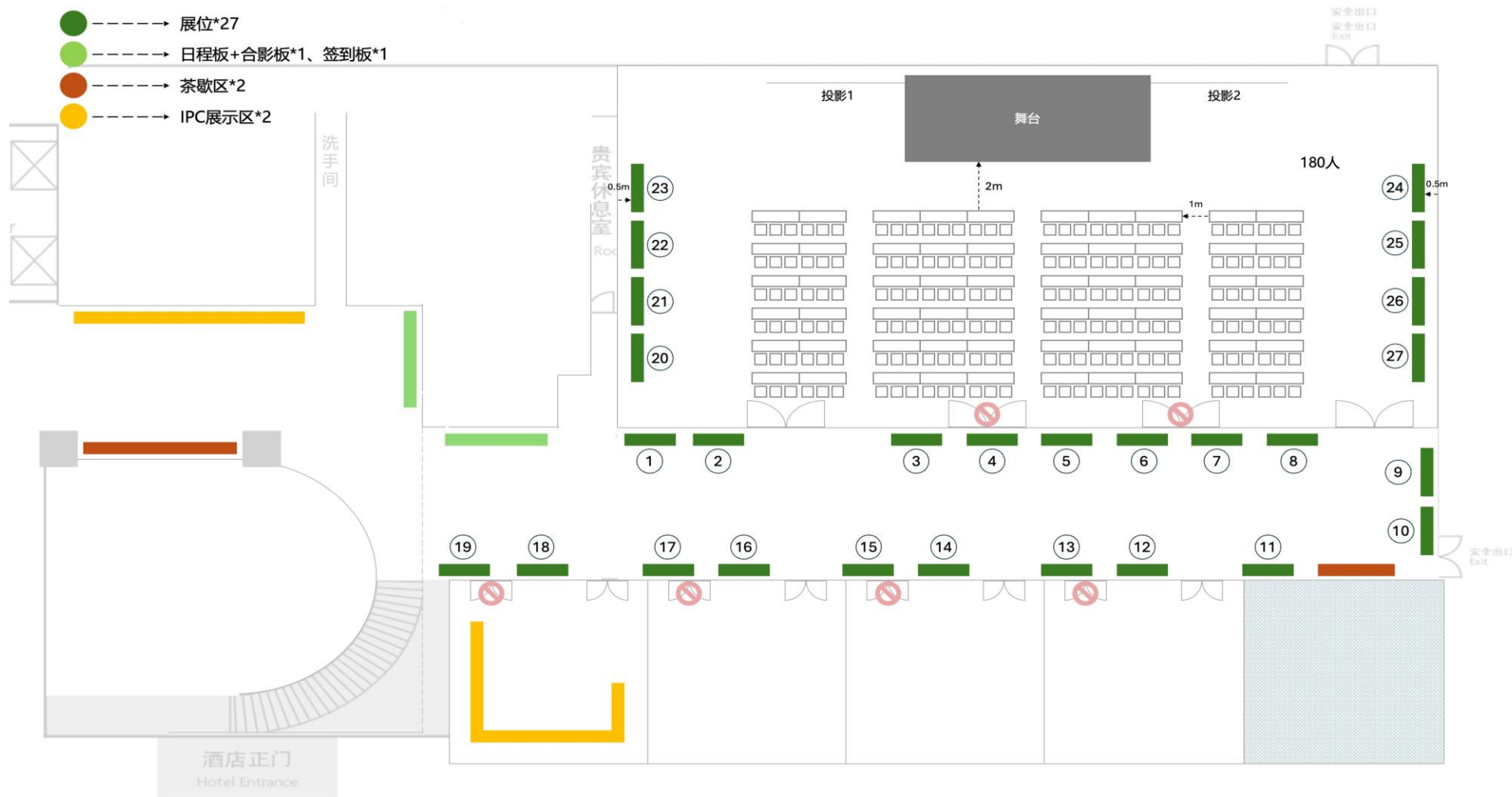
■ 选位时间与流程：



注：

1. 签约时间以IPC收到企业盖章合同所记录的时间为准。如有异议，由组委会沟通后确认给赞助商
2. 若因赞助商原因（逾期未选位、取消赞助等）导致优先权失效，其序位将自动顺延至同等级下一位
3. 组委会保留根据现场布局、安全及观众动线进行微调的权利，并及时向已确认展位的企业发送最终调整结果

展位规划布局图



参与投稿

<https://cemac.ipc.org.cn/callforpaper>



- 荣获“优秀论文奖”的文稿将被推荐至具有行业影响力的专业期刊进行择优发表
- 入选演讲者将受邀在CEMAC大会技术论坛进行现场演讲
- 展示技术成果，提升个人与企业在行业内的影响力
- 与全球行业领袖面对面交流，拓展业务与学术网络
- 获邀参加CEMAC会员答谢与表彰典礼，见证荣耀时刻

报名参会

<https://go.ipc.org.cn/cemac2025>



- 深入了解电子制造领域的最新技术、标准动态与应用趋势，提升个人专业素养和行业敏锐度
- 与来自业界不同背景、领域的专家、学者、研究人员进行交流与经验分享
- 参观优秀企业的技术解决方案与创新成果，创造潜在合作机会

投稿主题范围

先进封装技术与未来生态构建

• 子议题范围：

- 先进封装产业生态与发展战略
- 先进封装材料创新与工艺保障
- 高密度集成与微缩化封装核心技术
- 先进封装中的热管理与功率密度挑战
- 系统级封装（SiP）的协同设计与应用创新
- 先进封装质量保障及标准化研究

新兴产业驱动下PCB&PCBA的机遇和挑战

• 子议题范围：

- 先进制造与工艺的演进趋势
- 先进材料的技术创新与应用
- 检验技术突破与实践路径
- 极限应用场景下的可靠性挑战与应对
- 高可靠性测试研究成果分享
- IPC装联标准的应用实践与关键案例解析

电子制造的数智化转型升级

• 子议题范围：

- 电子制造与智能技术融合创新
- 电子制造的智能决策与流程优化
- 数据驱动的电子智造应用解析
- AI引领电子智造转型与应用落地
- 智能工厂解决方案与典型案例分享
- 未来工厂标准体系与应用实践

电子制造ESG可持续发展探索和实践

• 子议题范围：

- 电子制造业ESG管理方向与最佳实践
- 出口出海企业ESG合规挑战与应对
- 上市公司ESG可持续发展报告现状与挑战
- 电子制造业供应链碳减排创新实践
- 电子制造业绿色清洁化学品管理
- 循环经济与低碳转型需求下的绿色电子制造材料

注：如您有其他行业热点或前沿议题，也诚挚欢迎您积极投稿，共同推动行业交流与发展。

摘要提交链接：<https://cemac.ipc.org.cn/callforpaper>

更多2025 IPC CEMAC电子制造年会资讯，请访问官网：<https://cemac.ipc.org.cn/>。关于摘要投稿问题，请联系赵文彬先生，邮箱：Willzhao@electronics.org

SHAPING A SUSTAINABLE FUTURE

共塑可持续未来

IPC[®] CEMAC
2025

CEMAC官网: cemac.ipc.org.cn

联系方式: MarketingChina@electronics.org

咨询热线: 400-6218-610

